

ひとわざ(一技)名: 半導体加工装置を使用した研削、切削加工

1. 概要(200字目安)

シリコンウェハをはじめ、金属、セラミック、ガラエポ、ガラス等の難切削材料の切断、研削等の受託が可能です。

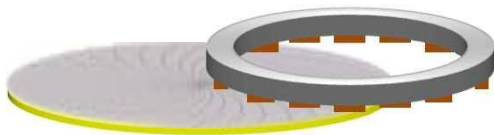
特に、加工精度においては、 $\pm 3\mu\text{m}$ と高精度の加工が可能です。

また、低コスト、短納期で対応いたします。

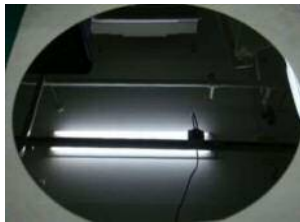
加工後の製品は、トレイ詰めや、真空梱包等、柔軟に対応いたします。

写真・図(要点説明)

バックグラインド(研削加工)

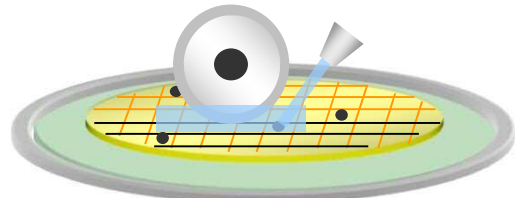


製品を砥石によって研削します。
また、ポリッシュ装置も保有していますので、鏡面仕上げが可能です。(おもにシリコン)

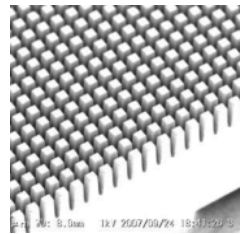


鏡面仕上げ

ダイシング(切削加工)



製品をダイヤモンドブレードによって切り分けます。溝入れ加工も可能です。



シリコン基板の
溝入れ加工(30 μm 幅)

2. 企業概況

フリガナ	カブシキガイシャ ニチワコウギョウ	フリガナ	テラサキ シゲル
会社名	株式会社 ニチワ工業	代表者名	寺澤 茂
		フリガナ 窓口担当	サウ ツム 佐藤 努
事業内容	半導体、難切削材の研削、切削加工	URL	http://www.nichiwak.co.jp
主要製品	精密研削・切削加工、情報画像サプライ品の製造		
フリガナ	カブシキガイシャ ニチワコウギョウ		
住所	〒391-0003 長野県茅野市本町東3-17		
電話/FAX	0266-72-6840	E-mail	HPから問い合わせください
資本金(百万円)	15	設立年月	1970年3月
		売上(百万円)	—
		従業員数	125

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

- ①・ISO9001:2015年度版取得済み
- ・ISO14001:2015年度版取得済み

②半導体用の高精度設備を多数そろえておりますので、上記加工だけでなく、ダイシング、各種トレー詰め、仕様に
応じた梱包状態で出荷が可能です。また、超純水製造設備を所有しておりますので、洗浄作業等も可能です。